

Серия K229	МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ	3.458.004 ПСИ
Тип K2XL29I	Многофункциональный логический элемент	П а с п о р т

Микросхема соответствует техническим условиям
ОК0.348.018 ТУ.

1. Функциональное назначение - многофункциональный логический элемент.
2. Режим работы:
 - напряжение питания, В минус 5 ±5%
 - мощность, потребляемая от источника питания, Вт, не более 1,3
3. Основные электрические параметры:
 - U_{вых0}* - выходное напряжение "лог.0", В минус (от 1,47 до 1,69)
 - U_{вых1}* - выходное напряжение "лог.1", В минус (от 0,7 до 0,9)
 - t_{зд}* - среднее время задержки распространения на один логический элемент, нс, не более 3 (при C_н ≤ 30пФ)
 - U_{уст}* - помехоустойчивость, В, не менее 0,16
 - N* - коэффициент разветвления 25
4. Указание содержания драгоценных металлов:
см. ящик "Содержит драгметаллы".
5. Указания и рекомендации по установке, монтажу, эксплуатации
 - з) Рекомендации по лужению методом погружения в расплавленный припой:
 - температура расплавленного припоя, °С, не более 250
 - время погружения, с, не более 2
 - расстояние от корпуса до верха припоя (по длине вывода), мм, не менее 2

допустимое количество погружений, не более 2
интервал между двумя погружениями, мин, не менее 5
припой и флюсы - по нормальи НО.054.063.

б) Рекомендации по установке:

крепление микросхем к печатной плате в аппаратуе может быть произведено вплотную с помощью приклеивания или механическим способом с последующей распайкой выводов.

в) Рекомендация по пайке одножальным паяльником:
температура жала паяльника, °С, не более 265
мощность паяльника, Вт, не более 40
время касания каждого вывода, с, не более 3
интервал между пайками соседних выводов, с, не менее 3
расстояние от корпуса микросхемы до места пайки (по длине вывода), мм, не менее 2
Жало паяльника должно быть заземлено.

г) Рекомендации по групповой пайке:
температура жала группового паяльника, °С, не более 265
время воздействия (одновременно на половину или все выводы), с, не более 2
расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода), мм, не менее 2
интервал между двумя повторными пайками одной микросхемы, мин, не менее 5

Жало группового паяльника должно быть заземлено.

П р и м е ч а н и е. При пайке или сварке выводов следует принимать меры, исключающие тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

д) Рекомендации по очистке от флюса, влагозащите:
рекомендуется применять для очистки от флюса жидкости в соответствии с нормалью НО.054.063 (спирт);
промывка микросхем от флюса после распайки на платы

с применением ультразвука в спирто-бензиновой смеси не допускается;

рекомендуется для влагозащиты применять лак УР-231, МРТУ6-10-863-69, или Э-4100, МРТУ6-10-857-69;

приклейку рекомендуется производить эластичными термостойкими герметиками ВГО-1, ТУ-38-3Г-346-69, "Эласторил-11-01" марки А, ТУ-6-02-655-71.

Примечание. Для очистки от флюса, влагозащиты и приклейки микросхем допускается применять любые другие моющие жидкости, лаки, не оказывающие вредного химического воздействия на покрытие, маркировку и материалы корпусов, после согласования со специализированной организацией по применению интегральных микросхем и проведения соответствующих испытаний.

6. В аппаратуре должен быть обеспечен такой типовой режим работы микросхемы, чтобы температура на поверхности корпуса не превышала 80°C .

7. Условия эксплуатации:

температура окружающей среды от минус 45 до $+55^{\circ}\text{C}$;

относительная влажность воздуха при температуре

$T = +25^{\circ}\text{C}$ 98%;

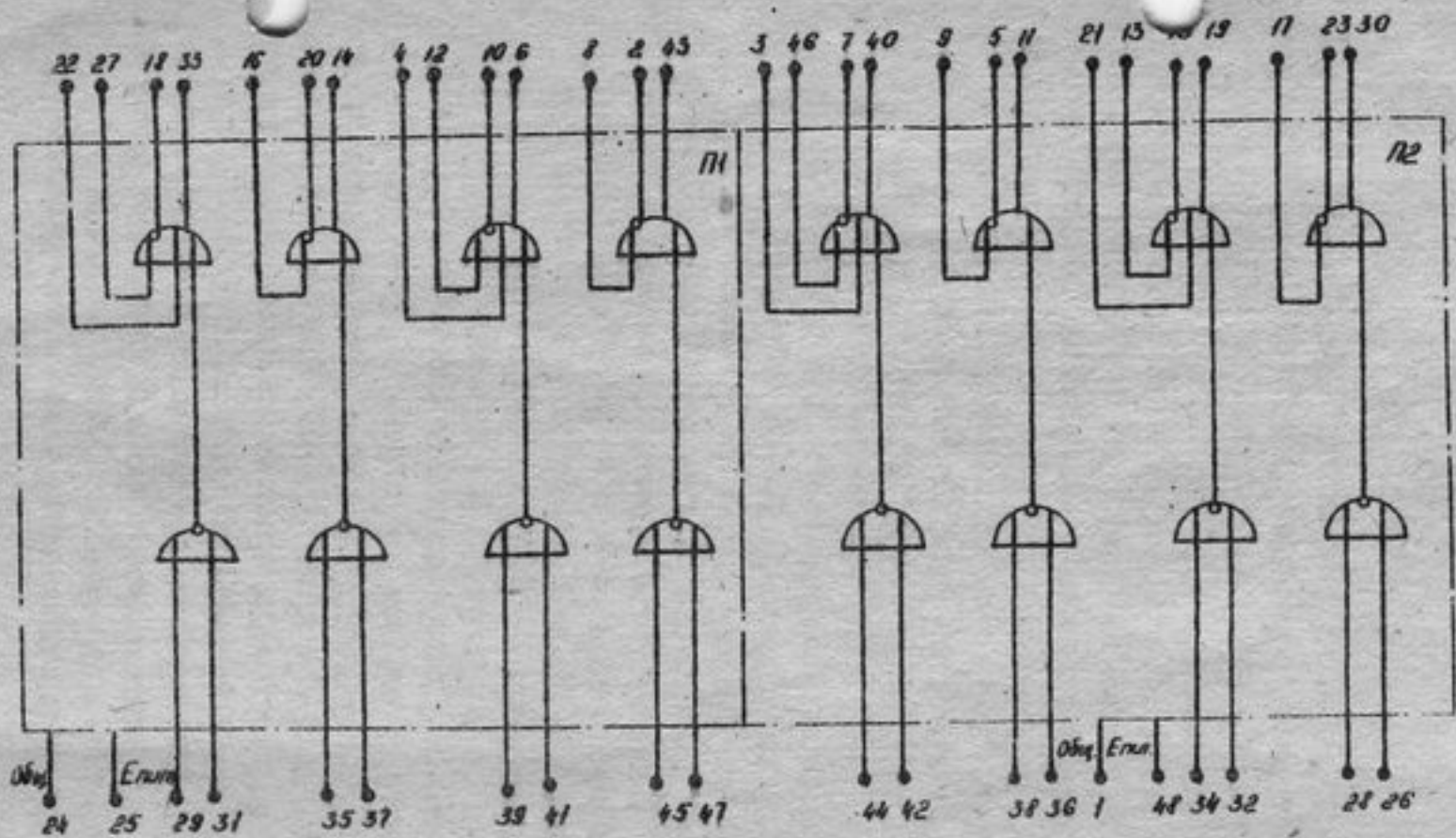
вибрация с ускорением до $10 g$ в диапазоне частот от 1 до 600 Гц;

многократные удары с ускорением до $75 g$;

линейные (центробежные) ускорения до $25 g$.

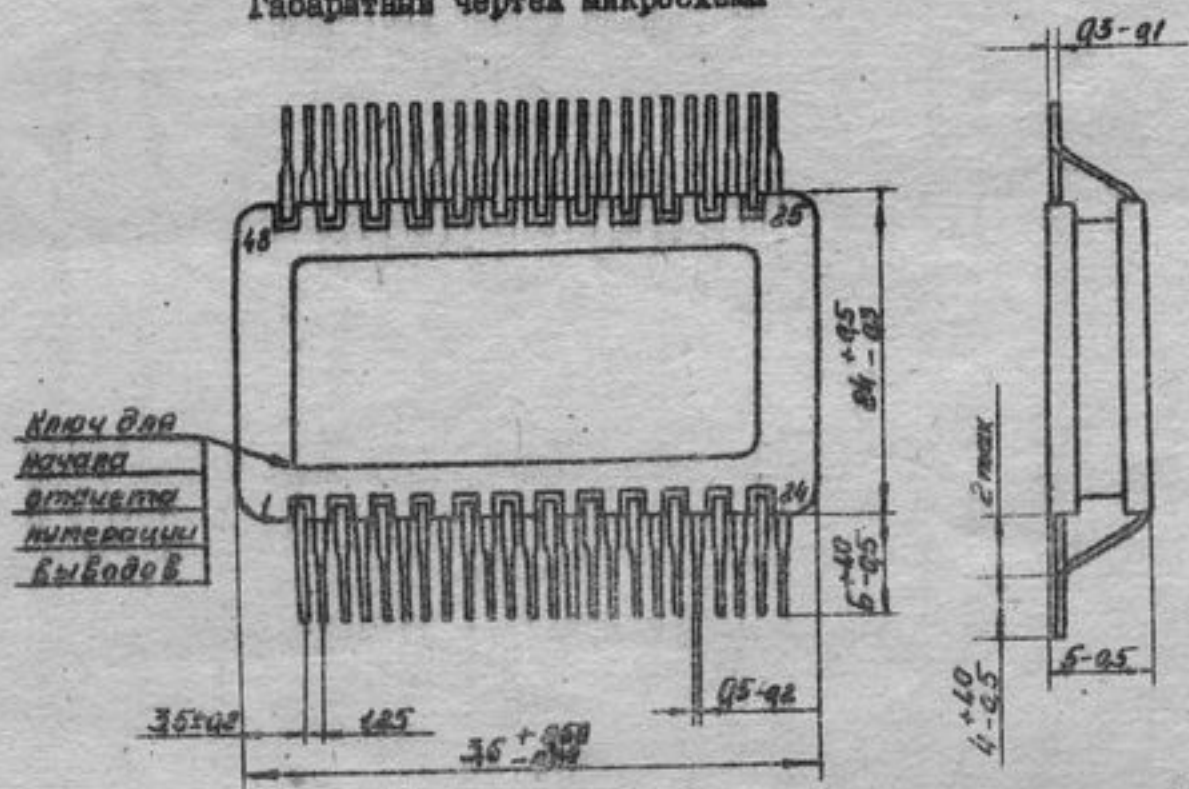
8. Время наработки - 10.000 ч.

9. Срок хранения - 6 лет.



Функциональная схема

Габаритный чертёж микросхемы



Масса микросхемы не более 12 г.

Ю. Гарантия предприятия-изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждой поставляемой микросхем всем требованиям ГОСТ 18725-73 и ТУ в течение срока сохраняемости или наработки при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению, монтажу и эксплуатации, установленных в ГОСТ 18725-73 и ТУ.

Срок гарантии исчисляется со дня отгрузки микросхем потребителю.

II. Дата выпуска

Штамп ОТК
"8" 1975 г.



"СОДЕРЖИТ ДРАГМЕТАЛЛЫ"

Золото-0,0088644г

Серебро-0,16442г

Палладий-0,0459г